RF 反応性スパッタリングによる CNx 膜形成における摩擦特性に 及ぼすスパッタガスの影響

Effects of sputtering gas on the friction property of CNx films prepared by RF reactive sputtering

•	
城谷 友保	Tomoyasu SHIROYA
工学専攻 工学研究科 博士後期課程	Graduate School of Engineering
坂本 幸弘	Yukihiro SAKAMOTO
機械サイエンス学科 教授	Dept. of Mechanical Science and Engineering, Professor
斎藤 邦夫	Kunio SAITOH
日本コーティングセンター(株)	JAPAN COATING CENTER CO., LTD.
川名 淳雄	Atuo KAWANA
日本コーティングセンター(株)	JAPAN COATING CENTER CO., LTD.
•	•
2014年9月19日受付	Received : 19 September 2014

CNx, which is nitrogen containing Diamond-Like Carbon (DLC), has excellent mechanical properties including high hardness and a very low friction coefficient. In this work, the effects of sputtering gas on the mechanical properties of CNx films prepared by RF reactive sputtering was investigated. CNx films were prepared using an RF magnetron sputtering apparatus. Graphite was used as the target and Si as the substrate. The substrate was etched with BHF for 5 minutes. RF power and pressure were fixed to 200 W and 0.4Pa, respectively. Ar and N₂ were used as sputtering gases with ratios of Ar/N₂ = 1/0, 1/1, 1/3, and 1/5. The substrate electrical potential was set to either grounded or floating. The sputtering time was 60 minutes. CNx films were prepared after pre-sputtering using same conditions for 10 minutes. The film structures were analyzed using SEM, XPS, and Raman spectroscopy and The mechanical properties were measured using nano-indentation testing and ball-on-disk friction testing. Results showed that the deposition rate of CNx films was increased by adding nitrogen gas to Ar using the floating substrate holder. However, the hardness was decreased by the addition of nitrogen gas to Ar. The nitrogen content was increased slightly (up to 25 percent) due to the increasing nitrogen gas in the sputtering gases.

キーワード: CNx, Raman spectroscopy, nano-indentation, friction test, RF sputtering

1. 緒 言

非晶質窒化炭素 (CNx) は Diamond-like Carbon (DLC) に N を含有させたものであり,高硬度を有し,N₂ ガス雰 囲気中では無潤滑で 0.009 という非常に低い摩擦係数と耐 摩耗性を示し¹⁾,高い硬度と弾性回復率を示すことが明ら かになっていることから²⁾,DLC に代わるハードディス ク表面の保護膜への適用が期待されている³⁾⁴⁾.このよう な優れたトライボロジー特性を有している CNx であるが, 非常に高い体積抵抗率と低い誘電率も有していることから, (Ultra Large Scale Integration) ULSI の層間絶縁膜や重 粒子イオン検出器への応用も検討されている⁵⁾⁶⁾,など幅 広い分野において産業的応用が期待されている.このよう に CNx は優れた物性を持つと報告されており,DLC と比 較して硬度は劣るものの,トライボロジーや電気特性に おいて優位性をもつ可能性を秘めている. CNx の特徴は DLC と同様に,物理気相法 (PVD) や化学気相法 (CVD) など,種々の薄膜形成プロセスを用いることによって,比 較的容易にさまざまな基板材料に室温程度での成膜が可能 である点にある. さらに,大面積 3 次元形状成膜も比較的 容易であり,これは CNx コーティングの大きな優位性で あるといえる. CNx はこれまで,メカノ合成⁷⁾,液相法⁸⁾, CVD 法⁹⁾,イオンビーム蒸着法¹⁰⁾,レーザアブレーショ ン法¹¹⁾,反応性スパッタリング法¹²⁾およびアークイオン プレーティング法¹³⁾などでの合成が報告されており,窒 素含有量は最大で 45%程度で,膜中には C-C 結合, C-N 結合, C=N 結合および C \equiv N 結合などの結合状態¹⁴⁾が 存在することが明らかとなっているが,非晶質であるため に,物性および構造が作製法および作製条件によって大き く変化してしまう.気相合成による CNx の合成を例に挙 げると,膜中の含有窒素量¹⁵⁾および水素含有量¹⁶⁾,基板 バイアス¹⁷⁾,成膜圧力¹⁸⁾,放電出力および成膜温度¹⁹⁾な どが因子となる.これらすべての因子において統一的な見 解は得られてはいないため,系統だった研究が必要である. とくに,CVD 法によって CNx 膜を作製する場合,炭素源 として水素を含む炭化水素ガスを使用するため,含有水素 量の制御は困難であると考えられる.しかし,これらの成 膜パラメータを制御できれば,適用先によって異なる任意 の特性を製品上に付与することが可能であることを意味し ている.例を挙げると,エンジンに使用される軸受のオー バーレイ(最表面層)を適用先とした場合,なじみ性と呼 ばれる順応性が必要とされるため,軟質な CNx 膜が適し ていると考えられる²⁰⁾.

一方,反応性スパッタリング法は,水素を含まない固体 炭素から気相中に炭素を供給することが可能であり,スパッ タ時に反応ガスを添加することにより化合物等の作製が可 能で,添加元素の制御が比較的容易であり,反応ガスの分 圧調整,成膜温度および基板バイアスなどの成膜パラメー タを変化させることによって,膜質の制御が可能である.

そこで、本報告では、膜質制御が比較的容易である RF 反応性スパッタリングをとりあげ、CNx 膜形成における 成膜パラメータとしてスパッタガス中の N2 分圧と試料台 電位が膜構造および機械的特性に及ぼす影響について検討 した.

2. 実験装置および方法

2.1 スパッタ膜の作製

CNx 膜および比較のための DLC 膜の作製には RF マ グネトロンスパッタリング装置を用いた.本成膜装置は 13.56MHz の高周波をターゲット電極に印加させ,発生し たプラズマによって電極を構成している材料にスパッタリ ングさせて成膜を行う.また,成膜には4元ターゲットの うちの1ヶ所を成膜に使用した.図1に RF マグネトロン スパッタリング装置の概略図,表1にスパッタリング条件 を示す.

試料台はスイッチにより接地および絶縁の切り替えが可 能であり、以降は試料台を接地した条件を「アース」、絶 縁した条件を「フローティング」と記述する. 基板には単 結晶 Si を使用し、自然酸化層の除去を目的として5分間 緩衝稀フッ化水素酸溶液に浸漬した. ターゲットにはグラ ファイトを使用し、ターゲットに印加する高周波の電力は 200W とした. 成膜前にターゲット表面の清浄化のために 10 分間プレスパッタを行った.

DLC 膜の作製にはスパッタガスとして Ar を用い, CNx 膜の作製には Ar-N2 混合ガスを使用し, N2 分圧と試料台 電位を変化させて成膜を行った.

生成物の評価には断面 SEM による膜厚測定, ラマン分 光分析による質的評価, XPS による化学結合状態分析を 行った.



図1 RFマグネトロンスパッタリング装置概略図

表1 スパッタリング条件

基板	Si
ターゲット	グラファイト
RF 出力 (W)	200
压力 (Pa)	0.4
スパッタガス	Ar,Ar:N ₂ =1:1,1:3,1:5
試料台電位	アース,フローティング
成膜時間 (min)	60

2.2 機械的特性評価

作製した皮膜の機械的特性評価として,ナノインデン テーション試験による硬さの測定,ボールオンディスク型 摩擦試験機(FRICTION PLAYER FPR-2000/株式会社レ スカ)により生成物の摩擦係数を測定し摩擦摩耗特性を評 価した.表2に摩擦試験条件を示す.

 相手材
 SUJ2

 荷重 (N)
 0.1

 ボール直径 (mm)
 4.76

 摩擦速度 (mm/s)
 62

 摩擦距離 (m)
 35

 試験温度
 室温

 試験温度 (%)
 50±5

表2 摩擦試験条件

3. 結果および考察

3.1 得られたスパッタ膜の評価

図2に異なるスパッタガスで作製したスパッタ膜の膜厚 を示す.

スパッタガスへの N₂ 添加により, 膜厚が増大する傾向 が確認される. これは, 生成物中への N の含有により, 密度および膜構造が変化したためであると考えられる. ま



図2 異なるスパッタガスで作製したスパッタ膜の膜厚

た.スパッタガスに N2 を添加して作製した場合. 試料台 電位をフローティングにすることによって、さらに膜厚が 増加する傾向が確認される.これは、高周波による試料台 のセルフバイアス状態がアースとフローティングの条件で 異なるためであると考えられる.通常の高周波を利用した スパッタリングでは、試料台およびチャンバ壁面が接地さ れていた場合,発生するセルフバイアスよって入射するイ オンで常にボンバードされている²¹⁾.しかし.フローティ ングの状態では電荷を逃がすことができないため、チャー ジアップが起こり、入射イオンによるスパッタリングが起 きにくくなり、堆積した粒子の再蒸発等が抑えられたため、 膜厚が厚くなったのであると考えられる.しかし,Ar ガ スのみをスパッタガスに使用して作製した場合はアースの 条件の方がフローティングよりも、膜厚が厚いことが認め られる.これは、基板に入射する C⁺ などのイオンがエッ チングよりも堆積に働いたためであると考えられる.

図3に生成物のラマンスペクトルを示す. ラマン分光分 析の結果、アースおよびフローティングのいずれの生成 物においても 1580cm⁻¹ 付近のグラファイト構造に起因す るGバンドピーク,構造欠陥に起因する1350cm⁻¹付近の Dバンドピーク,が認められ,波形より DLC と同様な構 造²²⁾ であることが認められる.また,これらのラマンス ペクトルに対して波形分離を行い、各スペクトルの面積比 を算出した結果、アースの条件で作製した場合、スパッタ ガス中の N2 分圧の増加に伴い。構造欠陥に起因する D バ ンドの比率が低くなることが確認された.一方.フローティ ングの条件で作製した場合は、いずれの生成物もGバン ドとDバンドの比率はほとんど変化せず、一定であるこ とが確認される、これは、試料台電位がアースの状態では 入射するイオンにより膜のエッチングが促進されるため. 膜中の安定な構造が残こり、構造が微細化したためである と考えられる.

図4に生成物のClsスペクトルを示す.図4より,Cls スペクトルにおいて、スパッタガスにArのみを用いた場 合はC-Cおよび-C=Oに起因するピークが確認され、N2 添加時にはC-Cおよび-C=Oに加え、C-N、=C-N=C-およ びC = Nに起因するピークが確認される.このことから スパッタガスにAr-N2系を用いることによって、生成物へ



のN含有が認められる.また、スパッタガス中のN2分圧 の増加に伴い=C-N=C-およびC=N結合のピーク高さの 増大が確認される.これは、スパッタガスのN2分圧の増 加に伴い、生成物中の化学結合状態がC-Nから=C-N=C-およびC=N結合に結合状態が変化しているためである と考えられる²³⁾.

図5に XPS スペクトルより算出した生成物の表面元素 比を示す.生成物のN含有率はスパッタガスにN2を添加 して作製した時において、13% ~ 26% であり、N2分圧の 増加により、わずかにN含有率は増加するが、全体的に N含有率は少ないことが明らかとなった.これは、N2分 圧の増加にともなって生成物中の化学結合状態が C-N 結 合から =C-N=C-および C = N 結合に変化しているためで あると考えられる.

また、試料台電位がフローティングの条件において、基

板のチャージアップによる N²⁺ 等のイオンの入射が抑えら れているにもかかわらず,スパッタガス中の N² ガス量の 増加にともなって N の含有量が増加する傾向が認められ る.これは,グラファイトを電極に用いた Ar-N² 雰囲気



図4 生成物の C1s スペクトル

中の放電では、プラズマ中に電子やイオン等の荷電粒子の ほかに、CN ラジカルなどの中性活性種が存在する²⁴⁾. そ して、それらの中性活性種は CN 膜の形成に働くため、結 果的に N 含有量が増加したのであると考えられる.

3.2 機械的特性

図6に異なるスパッタガスで作製した生成物のナノ インデンテーションの硬さを示す. 試料台電位をアー スにして,スパッタガスにArのみを用いて作製した 生成物の硬度は12.94GPaであるのに対し,スパッタガ スにAr:N₂ = 1:1を用いて作製した生成物の硬度は 8.48GPaであった. さらに,Ar:N₂ = 1:3では7.79GPa, Ar:N₂ = 1:5では5.16GPaと,スパッタガス中のN₂分 圧を増加させることによって,生成物の硬度が低下する傾 向が認められた,これは、ラマンスペクトル結果のN₂分 圧の増加によるGバンド成分の増加と相関を示しており, XPSの結果からも、生成物中の=C-N=C-およびC = N 結合成分が増加しているためであると考えられる²⁵⁾.

一方, 試料台電位をフローティングにして作製した場合 は, スパッタガスに Ar のみを用いて作製した生成物では 9.97GPa, Ar:N2=1:1 では 4.03GPa, Ar:N2=1:3 では 4.29GPa,



(a) アース



(b) フローティング

図5 XPS スペクトルより算出した生成物の表面元素比

Ar:N2=1:5 では 5.16GPa とスパッタガスに N2 を添加して 作製した生成物において、大幅な硬度の低下が確認され、 ラマンスペクトルとの硬さの相関は得られなかった. これ は、フローティングの条件の際には、基板に入射する中性 活性種が主として成膜に寄与しているため、イオンの入射 による膜の再蒸発等が抑えられたためであると考えられ る. また、Ar:N2=1:5 の条件を除き、試料台電位をアー スにして作製した生成物のほうが硬度は高い値を示した. これは、試料台電位がアースの条件では、フローティング の条件とは異なり、膜がイオン衝撃に曝されながら成長す るため、膜中に応力や強固な結合が残りやすくなるためで あると考えられる.

図7に生成物の摩擦係数を示す.

スパッタガスに Ar のみを用いて作製した場合では、0.1 前後の非常に低い平均摩擦係数値を示し、スパッタガスに Ar と N₂の混合ガスを用いて作製した場合では、スパッ タガスに Ar:N₂=1:3 用いて、試料台電位がアースおよびス パッタガスに Ar:N₂=1:5 を用いて、試料台電位がフロー ティングの条件で作製した場合を除き、0.2 前後の平均摩 擦係数値を示した.これは、空気中での CNx 膜の典型的 な摩擦係数値であり、他の研究グループでも同様の値が 報告されている²⁶⁾.しかし、スパッタガスに Ar:N₂=1:1 を用いて、試料台電位がアースおよびスパッタガスに Ar:N₂=1:5 用い、試料台電位がアースの条件で作製した生 成物の最低摩擦係数値は、0.05 付近の非常に低い値を示し ている.CNx 膜の超低摩擦現象は窒素雰囲気中での摩擦



図6 異なるスパッタガスで作製した生成物のナノインデン テーション硬さ



図7 生成物の摩擦係数

試験時にのみ起こると報告されているが、今回の条件で作 製した生成物は大気中での摩擦試験であるにも関わらず、 非常に低い摩擦係数値が得られた.これは、CNx 膜の超 低摩擦現象が大気中でも起こる可能性があるということを 意味しており、より細かな摩擦試験条件の検討などを行い、 超低摩擦現象発現のメカニズム解析を行う必要があると考 えられる.

以上の結果から,他の多くの報告にも挙がっているよう に、基板へのイオン照射は CNx 膜の構造に大きく影響を およぼし²⁷⁾²⁸⁾,今回のようなプラズマを用いた CNx 膜の 作製においては、皮膜を硬質化したい場合には試料台を接 地し、プラズマ中の N²⁺ などのイオンを基板に積極的に入 射させることが有効であると考えられる.さらに、これら の知見に加えて本研究では、基板のチャージアップ、すな わち試料台を絶縁することによって、基板へ CN ラジカル などの中性活性種を積極的に入射させることが、CNx 膜 の軟質化に寄与し、大気中においても CNx が超低摩擦現 象を示す可能性がある知見が得られた.

4. 結 言

RF 反応性スパッタリングによる CNx 膜形成における スパッタガス中の N2 分圧と試料台電位が膜構造および機 械的特性に及ぼす影響について検討した結果,以下のこと が明らかとなった.

- 生成物はいずれも DLC と同様の構造であり、Nの 含有率は最大でも 25% 程度であることが明らかと なった.そして、試料台電位をアースにした条件で 作製した場合は、N2の添加と N2分圧の増加に伴い、 C=N,C ≡ N やグラファイト成分が増加して、硬度は 低下することが明らかとなった.
- 2) 試料台電位をフローティング作製した場合は、スパッ タガスへの N2 の添加によって、成膜速度は急激に増 加して、硬度は低下した.また、試料台電位をアース にした条件で作製した試料と比較すると、いずれも硬 度は低く、スパッタガスに N2 を添加して作製した場 合において、C=N および C = N 結合成分が多いこと が明らかとなった.
- 3) CNx 膜の摩擦係数は膜構造や窒素含有率と相関を示 さず、0.2 前後であるが、一部の皮膜は大気中でも超 低摩擦現象が発現する可能性があることが明らかと なった。

以上より,適切な N2 分圧および試料台電位で成膜する ことにより, CNx 膜の構造および機械的特性の制御の可 能性が示唆された.

5. 参考文献

- Koji Kato, Noritsugu Umehara, Koshi Adachi : Wear, 254, (2003) 1062.
- 2) Wang et al.: J. Appl. Phys. 101 (2007) 13501.
- 3) Li et al : Appl. Phys. Letts., 81, (2002) 1113.
- T. Ohana et al.: Diamond and Related Materials,10 (2001) 1093.
- 5) S. Nitta et al : Diamond and Related Materials,12 (2003) 219.
- 6) S. Nitta, Y.Aono:OYO BUTURI,71 (2002) 892 (in Japanese) .
- M.D. Alcal ´a et al. : Diamond and Related Materials,10 (2001) 1995.
- 8) Kiyota, et al. : e-J. Surf. Sci. Nanotech,7 (2009) 102.
- 9) J. Guo et al. : Thin Solid Films,542 (2013) 60.
- 10) Masao Kohzaki et al. : Journal of the Japan Society of Precision Engineering,64,1 (1998) 152.
- E. Fogarassy et al. : Applied Surface Science,197-198 (2002) 316.
- Yuki TOGASHI et al. : J. Vac. Soc. Jpn.,44,3 (2001) 306.
- K.-H. Lee, O. Takai : Surface & Coatings Technology, 200 (2005) 2428.
- Riichiro Ohota, Kyung-Hwang Lee, Nagahiro Sito,Yasushi Inoue, Hiroyuki Sugimura, Osamu Takai : Surface technology, 54, 11, (2003) 769.
- Hellgren et al. : Appl. Phys. Lett., 78 ,18 (2001) 2703.
- M. Othman et al. : Materials Chemistry and Physics,144 (2014) 377.
- 17) E.Z. Kurmaev et al. : Thin Solid Films,402 (2002) 60.
- 18) K. ROH et al. : Jpn. J. Appl. Phys.,47,11 (2008) 8530.
- G. Lazar et al. : Diamond and Related Materials,12 (2003) 201.
- 20) Atsushi OKADO : Journal of JIME ,38 ,5 (2003) 282 (in japanese) .
- 21) 小林春洋:スパッタ薄膜,p.171(日刊工業新聞 社,1998).
- A. C. Ferrari and J. Robertson : Physical Review, B61 (2000) 14095.
- 23) J. Ni et al.: Thin Solid Films, 516 (2008) 7422.
- 24) K. Kutasi et al. : Vacuum,68 (2003) 311.
- A. Champi et al.: Thin Solid Films,420-421 (2002) 200.
- Shinya SASAKI ; Handbook of diamond-like carbon films ,p.17 (NTN,2006)
- 27) M. Othman et al. : Thin Solid Films, 519 (2011) 4981.
- 28) D. TANAKA et al.: Jpn. J. Appl. Phys.,39 (2000) 4148.